

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华安基金管理有限公司（谢磊）、国投瑞银基金管理有限公司（李威）、创金合信基金管理有限公司（郭镇岳）、中信证券股份有限公司（赵宪、陈德城、黄伟民）、中信建投证券股份有限公司（邹鑫）、东方财富证券股份有限公司（张星宇）、天风证券股份有限公司（文灿曦）、国联证券股份有限公司（郭佳豪、吕烨帆、唐宇璇）、东北证券股份有限公司（李玖、武芄睿、张禹、孟爽）、申港证券股份有限公司（尤少炜）、西南证券股份有限公司（刘淑娴）、广东明析投资私募基金管理有限公司（叶惠仪、黄毅劼）、深圳市泽源私募基金有限公司（孙岩）、深圳市中益富民私募证券投资基金管理有限公司（邱观军）、保宁资本有限公司（黄静）、明富私募基金（杨帆）、珠海市怀远基金管理有限公司（李岩岩）、浙江壹诺投资管理有限公司（李清扬、徐高峰）、北京方圆金鼎投资管理有限公司（张凤琴）、深圳前海美华投资有限公司（甘炳林、胡仕祥、陈晓勇）、深圳市熙沅咨询有限公司（程默）、深圳望正资产管理有限公司（马力）、北京鼎萨投资有限公司（刘寻峰）等（排名不分先后）		
时间	2023年11月9日（星期四）下午14:00至16:30		
地点	劲拓光电产业园会议室、部分生产车间		
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 陈文娟女士		
	<b>一、接待人员介绍公司基本情况</b> <b>（一）公司简介</b> 劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中，建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园。		

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>（二）公司从事的主要业务</b></p> <p>公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设备及配套设备）、半导体专用设备、光电显示设备。</p> <p>1、公司设立以来持续深耕电子热工领域，被行业协会授予“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证、全球市场占有率领先。此项业务系公司领先优势业务，也是公司的基本盘。</p> <p>2、公司随后布局光电显示业务，产品突破海外技术封锁，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等的制程，得到京东方等国产面板厂商和大型模组厂的认可并实现长期深度合作。</p> <p>3、公司 2021 年起布局半导体专用设备业务，目前系公司集中资源发展的战略级业务。半导体专用设备实现关键技术突破，研制生产了半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等多款半导体热工设备、硅片制造设备，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力。2022 年为半导体专用设备规模化销售元年，相关设备产品累计交付服务客户超过 20 家，获得客户的认可、验收及复购。</p> <p><b>（三）公司的经营情况</b></p> <p>2023 年前三季度，公司实现营业总收入 55,679.04 万元，较上年同期增加 0.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,856.91 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,328.84 万元。公司 2023 年前三季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》。</p> <p><b>二、问答交流</b></p> <p><b>1、公司半导体封装设备主要用途是什么？</b></p> <p><b>回复：</b>公司半导体封装设备主要包含半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等，广泛应用于各类芯片元器件的封装过程，产品具体情况可以参见公司《2023 年半年度报告》。</p> <p><b>2、公司产品国产替代的情况是什么样的，未来的空间还有多大？</b></p> <p><b>回复：</b>电子装联业务方面，公司电子装联业务收入主要来自于电子热工设备，热工设备在行业内市场地位和市场占有率领先。公司还将继续保持与核心客户的深度合作，把握海内外市场机会，不断提升市场占有率。</p> <p>半导体专用设备方面，公司生产的半导体专用设备目前主要为芯片封装的热处理设备，产品对标美国等国产品和技术成熟度较高的企业。半导</p>
----------------------	--

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>体专用设备从 2022 年开始规模化销售，市占率具有较大提升空间，系公司目前集中资源培育发展的战略级业务。</p> <p>光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。公司将视主要客户的固定资产投资需求，积极把握机遇扩大销售规模。</p> <p><b>3、电子装联设备下游应用领域有哪些？</b></p> <p><b>回复：</b>电子装联业务系公司成立以来一直深耕的业务，也是目前占营业收入比重最大的业务；电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，应用范围较为广泛，不仅包含通讯电子、消费电子，还包含白色家电、汽车电子、航空航天电子等领域。</p> <p><b>4、电子装联业务下游的景气度如何？目前该项业务未来展望如何？</b></p> <p><b>回复：</b>广泛的消费电子行业除智能手机、PC 等，还包含汽车电子、智能家居等领域，近年来以智能手机为主的消费电子行业经历了一轮下行周期后，逐渐呈现企稳态势；而汽车电子等领域受到新能源汽车市场需求旺盛等因素影响，市场景气度相对好；泛消费电子行业呈现结构性行情，而大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新兴技术的应用，对于新型硬件需求产生刺激作用。行业需求回暖、固定资产投资复苏，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。</p> <p>公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，处于行业领先地位。随着有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化，以及更高精度、高速度、多功能方向发展，还需要具备非标准化设备服务能力。公司将继续通过研发创新、产品升级筑牢业务发展根基、深挖护城河，不断推动电子整机装联业务持续高质量发展。</p> <p><b>5、公司光电显示设备主要有哪些产品？公司光电显示设备收入有一定的波动，主要原因是？</b></p> <p><b>回复：</b>公司光电显示设备用于光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组的生产制造过程，按功能分类主要有 3D 贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM 焊接类设备、贴附机等，相关产品已经覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域。</p> <p>光电显示设备近年来主要受到下游需求波动和同行业竞争加剧的影响，订单有一些波动；加之产品有一定的验收周期，以及客户的集中验收等，致使不同会计期间收入可能有波动。总体上光电显示业务的下游市场</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>空间广阔，公司具备优质的客户资源，未来将发挥差异化竞争优势、争取更大的市场份额。</p> <p><b>6、公司开展半导体芯片封装设备业务的原因是什么？</b></p> <p><b>回复：</b>公司经前期市场调查和商业机会研判，依托于国内领先的热工设备领域的温度控制等核心技术，实现技术应用领域和产品线延展，从而顺利切入了半导体专用设备业务领域，快速开发定型了多款半导体专用设备产品。</p> <p>公司看好半导体封测行业的发展前景，继 2022 年首次实现半导体专用设备业务规模化销售后，未来将继续把握相关设备进口替代机遇，着力推进半导体专用设备业务高质量发展。</p> <p><b>7、公司半导体专用设备目前有哪些客户？对于目前有关产业链固定资产投资景气程度怎么看？</b></p> <p><b>回复：</b>公司半导体专用设备目前主要面向国内大型封测厂商，累计服务客户逾 20 家，其中包含优质的上市公司、大型企业。</p> <p>公司长期看好半导体封测产业链发展前景，当前积极接洽有关意向客户和潜在客户，未来将积极把握市场增量和存量机遇、力争加快相关应用领域的进口替代步伐。</p> <p><b>8、公司专用设备的价格是多少？</b></p> <p><b>回复：</b>公司专用设备分为电子装联设备、半导体专用设备、光电显示设备。根据不同设备用途、配置要求，以及定制化、智能化程度不同，其价格会有一定的差异。</p> <p><b>9、公司的 AOI 检测设备主要应用于哪些环节？</b></p> <p><b>回复：</b>AOI 为自动光学检测，AOI 检测设备是基于光学原理利用机器视觉对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一。</p> <p><b>10、公司后续的研发计划是什么？</b></p> <p><b>回复：</b>公司后续将继续攻关芯片封测等环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体设备，推动半导体专用设备产品拓展、性能提升、研发成果转化；同时汲取不同场景的应用经验，优化和提升电子装联设备、光电显示设备性能，提高产品技术壁垒。</p>
----------------------	--

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>11、能否介绍一下公司今年7月公告拟投资的科睿斯半导体科技（东阳）有限公司具体情况？</b></p> <p><b>回复：</b>该对外投资事项具体情况，详见公司2023年7月15日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》以及2023年7月31日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》。</p> <p><b>12、公司控股股东、实际控制人吴限先生拟委托公司表决权事项进展情况如何？</b></p> <p><b>回复：</b>公司控股股东、实际控制人吴限先生筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）委托其所持公司27.9%表决权，该事项可能导致公司控制权变更。吴限先生拟委托其表决权事项目前处于意向阶段，公司于2023年1月30日披露了双方《表决权委托意向协议》有关内容，同时结合双方后续签署的补充协议，该《表决权委托意向协议》有效期至以下三个时点中较早之日止：①委托方、受托方签署《表决权委托协议》且协议生效之日；②委托方、受托方签署《表决权委托意向协议之终止协议》且协议生效之日；③2023年12月31日。</p> <p>根据双方提供的书面文件：截至公司《2023年三季度报告》报告日，双方正就《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项方案进行深入论证和详细磋商，后续是否签署正式协议并实施、实施计划等均存在不确定性。</p> <p>本次控股股东拟筹划的公司控制权变更相关事项尚存在不确定性。针对该事项进展情况，公司将在获知有关进展后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，谨慎决策、注意投资风险。</p> <p><b>三、现场参观</b></p> <p>现场交流结束后，调研人员有序参观了公司部分电子装联设备、半导体专用设备及光电显示设备生产车间。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年11月9日</p>